**最新FO-WLP/PLP封裝技術與設備材料發展動向研討會**

報名表

**★** 活動地點：集思台大會議中心

**★** 參加費用：新台幣4,500元整 \*早鳥優惠：NTD 3800元

※請於開課前完成繳費，課程現場繳費 ，恕不享以上優惠資格。

**★** 傳真報名：(02)5593 3727，李先生收

**★** 洽詢電話：0923282722

**★** 洽詢Mail：kevin@next-opto.com

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司統編 |  | 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司名稱 |  | 發票抬頭 | ⬜同公司名稱 或 |  |  |  |  |
| **聯絡人資料** | 產業類別代碼 可複選(無代碼則直接填寫) |
| 電子信箱 |  \_\_ \_\_  | 參加者姓名 |  | 行動電話 |  |
| 部門/職稱 |  \_\_ / \_ \_ | 公司電話 | + ( ) # |
| 參加者資料 |  | 產業類別代碼 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 可複選(無代碼則直接填寫) |
| 電子信箱 |  \_\_ \_\_  | 參加者姓名 |  | 行動電話 |  |
| 部門/職稱 |  \_\_ / \_ \_ | 公司電話 | + ( ) # |
| 參加者資料 |  | 產業類別代碼 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 可複選(無代碼則直接填寫) |
| 電子信箱 |  \_\_ \_\_  | 參加者姓名 |  | 行動電話 |  |
| 部門/職稱 |  \_\_ / \_ \_ | 公司電話 | + ( ) # |
| 參加者資料 |  | 產業類別代碼 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 可複選(無代碼則直接填寫) |
| 電子信箱 |  \_\_ \_\_  | 參加者姓名 |  | 行動電話 |  |
| 部門/職稱 |  \_\_ / \_ \_ | 公司電話 | + ( ) # |
| 請將右方代碼，填入以下產業類別 | 1. 金融/保險 2. 半導體 3. 光電 4. 零組件 5. 通路/代理商6. PC週邊 7. 通訊 8. 軟體 9. 網路 10. 生產設備11. IA資訊電子 12. 消費性電子 13. 車用電子 14. 政府/政黨 15. 學術單位16. 公協會/財團法人 17. 公關/媒體 18.傳統產業 |  |  |  |  |